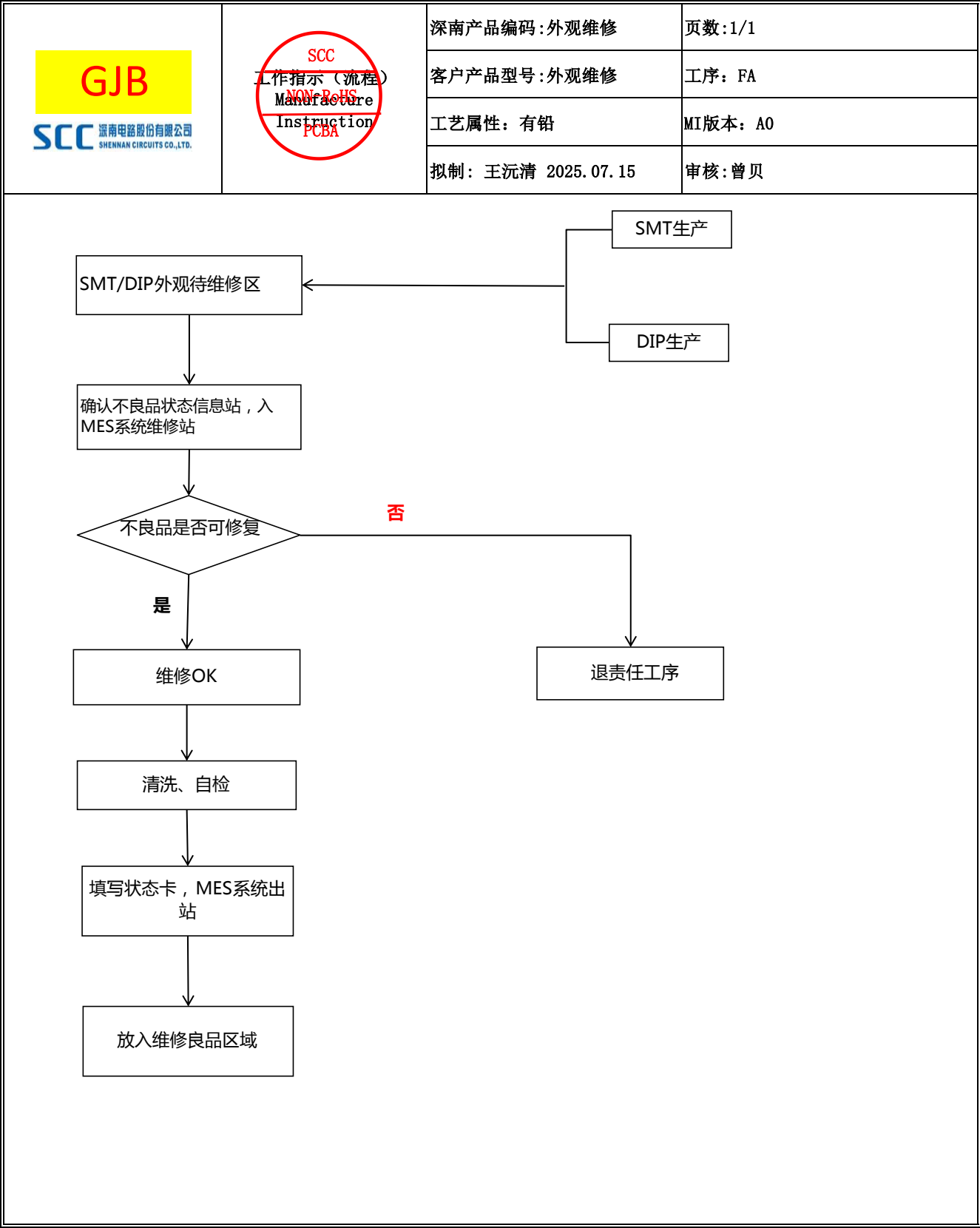


<div><div>GJB</div><div>SCC 深南电路股份有限公司 SHENNAN CIRCUITS CO.,LTD.</div></div>	<div>工作指示 (工艺目录)</div> <div>SCC NON-ROHS Manufacture PCBA Instruction</div>	深南产品编码:外观维修	页数:1/1
		客户产品型号:外观维修	工序:外观维修
		工艺属性:有铅	MI版本:A0
		拟制:王沅清 2025.07.15	审核:曾贝

工艺目录

生产工位	工位号	MI版本
更改记录表		A0
辅料、工装工具、仪器清单		A0
流程图		A0
涂抹助焊剂	W10	A0
片式器件拆除	W10	A0
焊盘整理	W20	A0
清洁	W30	A0
定位焊接	W40	A0
清洁	W50	A0
自检	W60	A0

<div><div>GJB</div><div>SCC 深南电路股份有限公司 SHENNAN CIRCUITS CO.,LTD.</div></div>		<div>工作指示 SCC Manufacture NON-RoHS Instruction PCBA</div>	深南产品编码:外观维修		页数:1/1
			客户产品型号:外观维修		工序: 外观维修
			工艺属性: 有铅		MI版本: A0
			拟制: 王沅清 2025. 07. 15		审核:曾贝
辅料、工装工具、仪器清单					
序号	辅料、工装工具、仪器名称	型号	编号	使用工位号	需要数量
1	OKI	烙铁MX-5200	N/A	W10	1把
2	烙铁头	SMTC-126/138/136/137 (370-390℃±10℃)	N/A	W10	1支
3	烙铁头	SMTC-038/036/037 (330-350℃±10℃)	N/A	W10	1支
4	烙铁头	PTTC-703/702 (360-380℃±10℃)	N/A	W10	1支
5	锡线	TP Core Solder Wire ALPHA TELECORE PLUS Sn63Pb37 081mm非RoHS	112103897	W10	1卷
6	吸锡带	吸锡线 2.0MM CP-2015	120100274	W10	1卷
7	助焊剂	AS Flux Alpha RF800 RoHS	109101651	W10	1瓶
8	无尘布	4寸*4寸无尘擦拭布110G	113100117	W20, W30, W40, W50, W60, W70	1盒
9	异丙醇	TP 试剂类 异丙醇 AR级 A 异丙醇 AR级（分析纯） 99.7%	109100907	W20, W30, W40, W50, W60, W70	1瓶
10	有铅锡膏	Sn63Pb37	112103977	W60	1瓶
11	茶色胶带	纸-高温遮蔽胶纸- 12mm*33m-波峰焊压接孔遮蔽, 茶色	T9002210000492	W40, W60	1卷
12	防静电镊子	陶瓷镊子 镊子头白色本土 防静电黑色 不锈钢+陶瓷	120112646	W10, W40, W60	1把
		防静电金属镊子 ESD-11	120100276	W10, W40, W60	1把
13	放大镜	高清40倍手持放大镜 120*35*25mm 型号: FE09	120113095	W30, W50, W70	1支
		高清20倍手持放大镜 120*35*25mm 型号: FE10	120113096	W30, W50, W70	1支
14	涂覆排笔	涂覆排笔 NT823 20.5CMX0.5CM 黑体白毛	116100149	W10, W40, W60	1支
15	热风枪	QUICK/861DW	N/A	W10, W40, W60	1台
16	热风筒	QUICK/885W	N/A	W10, W40, W60	1台



SMT生产

DIP生产

SMT/DIP外观待维修区

确认不良品状态信息站, 入MES系统维修站

不良品是否可修复

是

维修OK

清洗、自检

填写状态卡, MES系统出站

放入维修良品区域

否

退责任工序

GJB

SCC

深南电路股份有限公司
SHENNAN CIRCUITS CO.,LTD.

SCC

NON-RoHS

Manufacture

PCBA

Instruction

深南产品编码:外观维修

客户产品型号:外观维修

工艺属性:有铅

页数: 1/1

MI版本: A0

工位: W10

工位名称: 热风法拆卸安装 Chip

拟制: 王沅清2025. 7. 15

审核: 曾贝



图1 热风枪温度设置 220°C



图2 预热台温度设置 220°C



图3 热风枪温加热高度1-3mm



图4 涂抹助焊剂



图5 焊点预上锡



图6 加热熔融放置器件



图7 加热熔融放置器件



图8 焊点清洗

1. 材料部件:

物料编码	物料描述	配量
112103897	焊锡丝TP Core Solder Wire ALPHA TELECORE PLUS Sn63Pb37 081mm非RoHS	适量
NA	热风枪QUICK/885	适量
NA	预热台QUICK/854	适量
120100274	吸锡带 (2.0MM CP-2015)	1卷
109100561	助焊剂 (AS Flux Alpha RF800 RoHS)	适量
113100117	4寸*4寸无尘擦拭布110G	适量
116100149	涂覆排笔 NT823 20.5CMX0.5CM 黑体白毛	适量

2. 辅料. 工装工具. 仪器:

2.1、热风枪：QUICK/885，预热台QUICK/854、吸锡带、无尘布、防静电手环，静电手套。

3. 操作步骤:

3.1、预热台预热设置 220°C±5°C《热风枪操作规范》点检要求选用设置温度 220°C±5°C，风速设置在 70。见图1和图2

3.2、**涂抹助焊剂**：将焊接器件位置，使用毛刷蘸取助焊剂在被补焊点涂敷少量助焊剂。（图4）

3.3、**预上锡**：使用烙铁头 STTC-038 对片式器件一端加上少量锡，（见图4和图5）

3.4、**加热焊点熔融**：将热风枪置于器件上方约0.5CM处，施加热风，直至观察到焊料完全熔融（见图3）；把器件放置在PCBA焊接位置（见图6和7）；（注：器件在PCBA板子之间有粘合剂，如果使用了粘合剂，取装必须轻微转动才能取下器件。这个步骤必须是在焊料完全熔融后完成，以防止损伤发生）

3.5、**清洁**：使用无尘布蘸取异丙醇配合毛刷的方式擦拭；（见图8）

3.6、**自检**：确认器件方向于PCB板丝印方向一致，X_RAY检验确认器件底部焊接气泡标准管控 <25%，器件底部不允许有锡珠；

4. 注意事项:

4.1、戴防静电手环、防静电手套或手指套操作。

4.2、焊盘上不可有锡挂尖和高低不平。

4.3、焊盘拖平时,烙铁需轻轻水平移动,不能用力在焊盘上进行拖拉,以免损伤焊盘。

4.4、拖锡或清洁焊盘时发现焊盘异常,应立刻停止作业反馈相关管理人员。

4.5、返工时注意产品工艺属性, 不可交叉作业

返工操作流程

预热底炉设置

热风枪温度设置

器件外观确认

器件方向确认

清洁FOD

X_RAY检验

此资料属深南电路所有，未经许可，不得扩散。

返工操作流程

